

# 111 年度徵才活動

|        |  |            |            |
|--------|--|------------|------------|
| 公司名稱   | 精材科技(股)公司  | 攤位編號       | 免填         |
| 公司地址   | 桃園市中壢區吉林路 23 號 9 樓   | 統一編號       | 16741846   |
| 負責人    | 陳家湘  | 員工人數       | 1600       |
| 連絡人    | 張小姐  | 連絡電話       | 03-4331818 |
| E-mail | eva_chang@xintec.com.tw  |            |            |
| 公司網址   | www.xintec.com.tw  |            |            |
| 服務項目   | 晶圓封裝   |            |            |
| 勞動權益   | <input checked="" type="checkbox"/> 勞、健保 <input checked="" type="checkbox"/> 勞退 休假制度 _____ (凡屬勞動基準法規訂定之項目請填入此欄位)   |            |            |
| 福利制度   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■獎金：年終獎金保障 2 個月</li> <li>■禮券：三節禮券、勞動節禮券、生日禮券</li> <li>■訓練：完整訓練發展架構及多元學習管道</li> <li>■保險：勞保、健保、就保、勞工退休金提撥、員工及眷屬免費團保</li> <li>■補助：結婚禮金、生育祝賀金、住院慰問金、伙食費補助</li> <li>■娛樂：社團活動、家庭活動、體能競賽、歌唱比賽</li> <li>■其他：健身中心、員工舒壓按摩小站、健康檢查、特約商店</li> </ul>  | 是否進用身心障礙人員 | 是          |
| 公司簡介   | <p>精材科技股份有限公司成立於 1998 年，座落於台灣中壢工業區，是第一家將三維堆疊之晶圓層級封裝技術（3D WLCSP）商品化的公司。精材科技從事 CMOS 影像感測元件之晶圓層級封裝生產，並提供最佳的生產周期與極具競爭力的生產成本。</p> <p>由於具備高度的產品整合能力，三維堆疊之晶圓層級封裝技術可應用到各種不同的市場領域，如：消費電子、通訊、電腦、工業和汽車等。產品應用包括：影像感測器、光學感測器、電源管理積體電路、功率分離式元件、類比積體電路、混合信號積體電路、微機電系統感測器和整合式被動元件等。</p> <p>精材科技從事創新的三維堆疊之晶圓層級封裝製造服務，並以「誠信、創新、客戶導向」為公司的核心價值。精材科技是世界領先的先進封裝服務的供應商之一，期許成為最大的三維堆疊之晶圓層級封裝服務供應商。</p> |            |            |

| 職務名稱   | 人數 | 主要資格條件                                   | 待遇   | 工作內容  | 工作地點      | 備註 |
|--------|----|--|--|---|-----------|----|
| 無塵室技術員 | 50 | 高中職畢業<br>固定班, 需配合部門<br>需求調動日. 夜班<br>作二休二 | 日班:<br>25,250~41,500<br>夜班:<br>31,600~50,550<br>*薪資依工作績<br>效、加班而異<br>*到職後另有每<br>月新人期滿獎<br>金, 合計 10,000<br>元<br>*到職滿六個月<br>另有自我推薦獎<br>金 4,000 元 | 1. 無塵室機台操作<br>2. 產品檢驗(顯微鏡)                            | 中壢工業<br>區 |    |
| 製程技術員  | 10 | 高中/職畢, 作四休<br>三                          | 日班:<br>30,175~42,825<br>夜班:<br>38,025~52,655<br>*薪資依工作績  | 1. 課務處理及協助專<br>案事項<br>2. 工程資料整理與統<br>計<br>3. 異常處理及樣品製 | 中壢工業<br>區 |    |

# 111 年度徵才活動

|         |   |                     |   |   |       |  |
|---------|---|---------------------|---|---|-------|--|
|         |   |                     | 效、加班而異<br>*到職後另有每月新人期滿獎金，合計 10,000 元<br>*到職滿六個月另有自我推薦獎金 4,000 元 | 作   |       |  |
| 設備工程師   | 5 | 電子/電機/機械相關大學畢, 配合輪班 | 35,000~60,000   | 1. 設備裝機、保養、維修、機構改善<br>2. 設備問題分析、故障排除及改善<br>3. 設備產能與良率提升<br>4. 機台軟體/硬體改善                           | 中壢工業區 |  |
| 環安助理工程師 | 5 | 大學畢, 作二休二           | 31,000~45,000   | 1. 緊急應變相關事務管理, 包括培訓, 認證和 ERT 演練<br>2. 廠區巡檢與稽核<br>3. 安全系統及緊急應變設備之維護與管理<br>4. ESH 相關事務配合執行事項        | 中壢工業區 |  |
| 廠務副工程師  | 5 | 電子/電機/機械相關大學畢, 配合輪班 | 33,000~60,000   | 1. 電力機械輪班運轉 (含無塵室空調/一般空調、N2、PV、PCW, GAS 鋼瓶更換)&; 異常處理<br>2. 具電機或空調相關工作經驗<br>3. 系統改善<br>4. 主管交辦事項執行 | 中壢工業區 |  |
|         |   |                     |   |   |       |  |